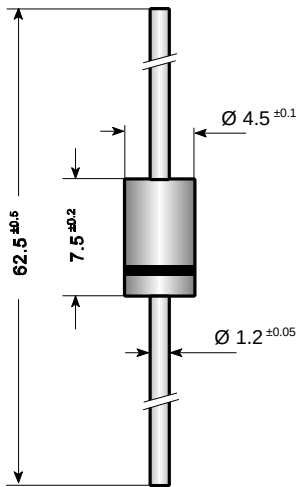


Si-Schottky-Rectifiers

Si-Schottky-Gleichrichter



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	3 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...100 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	~ DO-201
Weight approx. – Gewicht ca.	1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Rep. peak reverse voltage Period. Spitzensperrspg. V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage *) Durchlaßspg. *) V_F [V]
SB 320	20	20	< 0.55
SB 330	30	30	< 0.55
SB 340	40	40	< 0.55
SB 350	50	50	< 0.67
SB 360	60	60	< 0.67
SB 390	90	80	< 0.79
SB 3100	100	100	< 0.79

*) $I_F = 3 A$, $T_j = 25^\circ C$

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwertschaltung mit R-Last	$T_A = 50^\circ C$	I_{FAV}	3 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 Hz$	I_{FRM}	15 A ¹⁾
Rating for fusing, $t < 10 ms$ Grenzlastintegral, $t < 10 ms$	$T_A = 25^\circ C$	$i^2 t$	110 A ² s
Peak forward surge current, single half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ C$	I_{FSM}	150 A

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

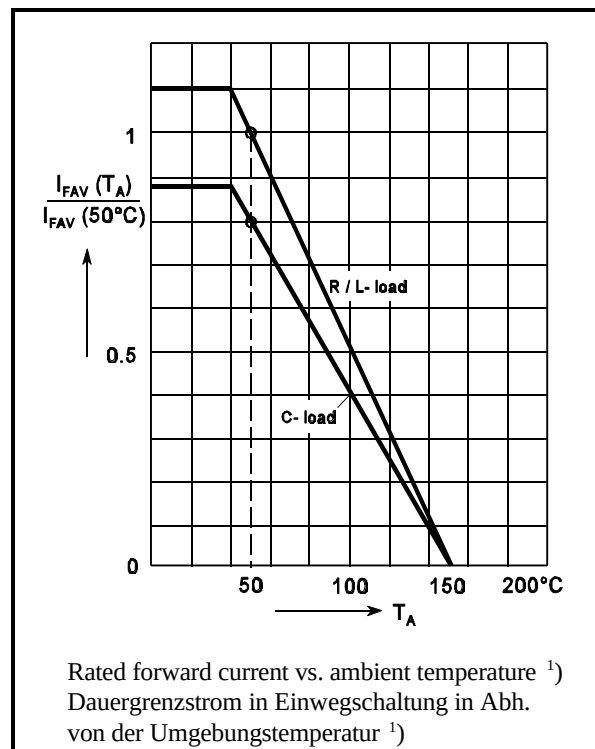
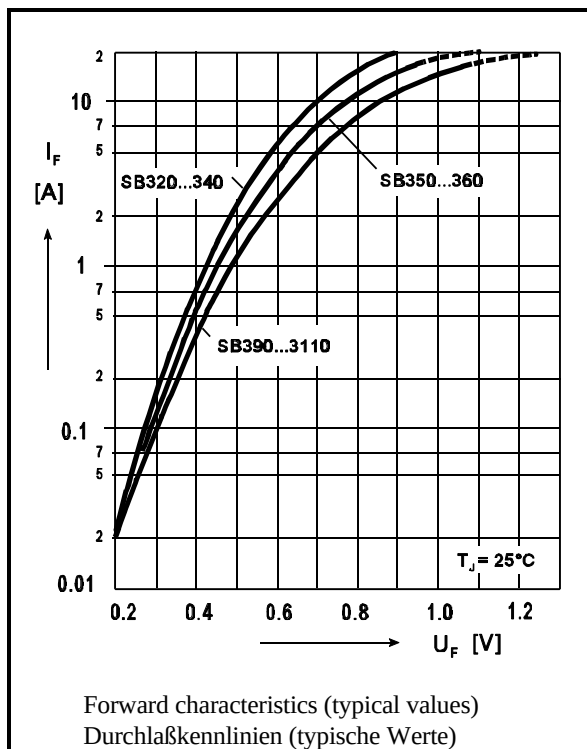
T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Leakage current	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	SB 320...360	I_R	< 0.50 mA
Sperrstrom			SB 390...3100	I_R	< 0.60 mA

Thermal resistance junction to ambient air	R_{thA}	< 25 K/W ¹⁾
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		



¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden